

国内使用が可能なTelec対応アンテナ&モジュールを標準搭載 届いた日からすぐ5Gが使える※「Edge Tank™」シリーズ

※通信事業者との5G回線契約が必要です。

Edge Tank™ 510

- ・ インテル® Core™ i7-1185G7E プロセッサ搭載
- ・ COM×2、USB3.1×2、USB2.0×2

5G対応

コンパクト

耐環境性能



5Gオールインワンパッケージ

「超高速」「超低遅延」「多数同時接続」を実現する次世代通信5G/ローカル5G。日本国内で通信するために必要なTELEC(技術基準適合認定及び設計認証)をすでに認証取得しています。新たに独自取得することなく届いたその日から安心してお使いいただけます。



5G通信で「sub6」を選ぶメリット

第5世代移動通信システム「5G」には、6GHz以下の周波数帯(主に3.7GHz帯および4.5GHz帯)を扱うsub6(サブシックス/サブロク)と28GHz帯を扱う「ミリ波」の2種類があります。sub6はミリ波と比べて通信可能範囲が広く、障害物の影響を受け難い特長があります。そして4G技術の転用ができることからsub6はミリ波と比べて先行して産業用途でも普及が進んでいます。

	メリット	デメリット
sub6	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信可能範囲が広い ・ミリ波と比べて、障害物の影響を受けにくい ・sub6は4G技術の転用ができる ・sub6はミリ波と比べて先行している(2021年現在) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信速度が遅い ・ミリ波と比べて、同時接続量が少ない
ミリ波	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信速度が速い ・sub6と比べて、低遅延 ・sub6と比べて、同時接続量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信可能範囲が狭い ・sub6と比べて、障害物の影響を受けやすい ・sub6はミリ波と比べて未だ普及していない(2021年現在)



生産工場・オフィス



交通・移動・物流



スマートシティ



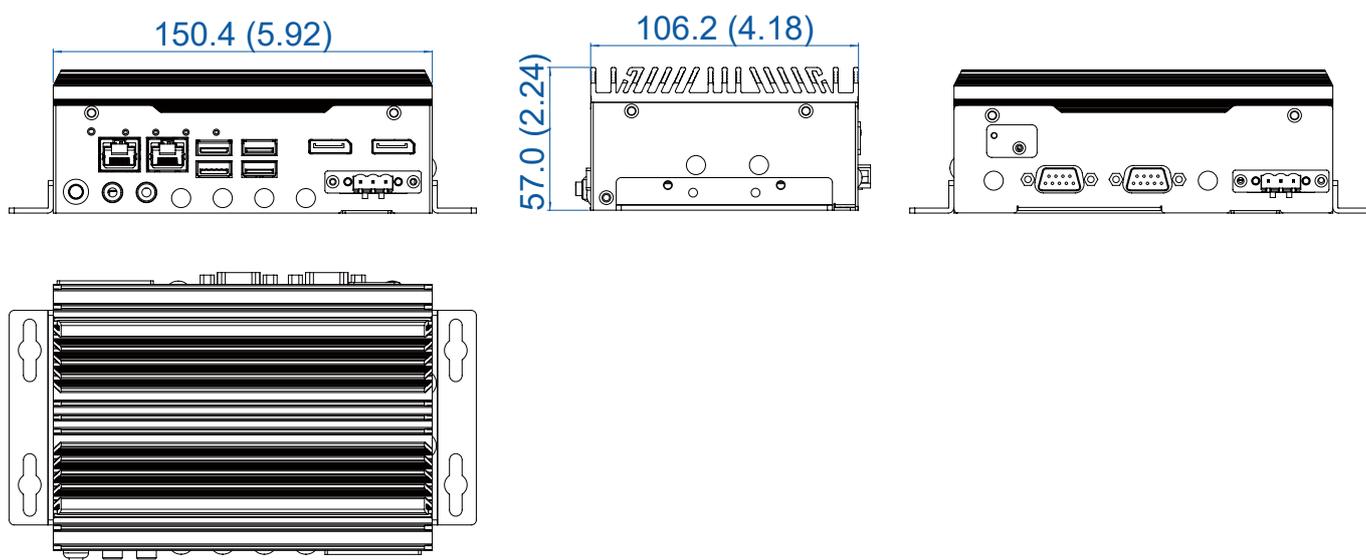
農林水産業

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名	Edge Tank™510	
5Gモジュール&アンテナ	sub6対応 ※TELEC取得済み	
SIMカードスロット	nanoSIM用スロット×1	
CPU	インテル® Core™ i7-1185G7E プロセッサー (4C/8T/1.8GHz/TB 4.4GHz/12MB/Emb)	
チップセット	SoC	
メモリー	16GB (16GB×1枚、DDR4-3200、-40~+85℃)	
SSD	256GB (2.5inch、SATA、MLC、-40~+85℃)	
I/O	COM	2 (RS-232/422/485 (ESD 8KV))
	USBポート	USB 3.1 ×2 USB 2.0 ×2
	LAN	1GbE ×2
ACアダプター	PWA-160W-WT	
外観寸法 (WxDxH)	150.4 x 106.2 x 57.0 mm	
重量	約1.3Kg	

■I/Oポート/寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年9月現在の内容です。

国内使用が可能なTelec対応アンテナ&モジュールを標準搭載 届いた日からすぐ5Gが使える※「Edge Tank™」シリーズ

※通信事業者との5G回線契約が必要です。

Edge Tank™ 520

- ・ インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサ
- ・ COM×4、USB3.2×6、DIO×16

5G対応

2.5GbE搭載

PoE+出力対応

耐環境性能



5Gオールインワンパッケージ

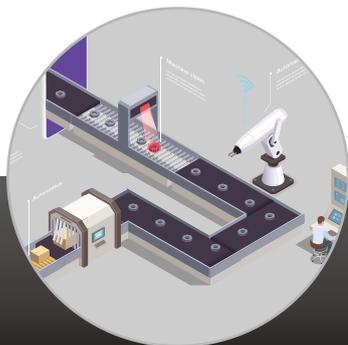
「超高速」「超低遅延」「多数同時接続」を実現する次世代通信5G/ローカル5G。日本国内で通信をするために必要なTELEC(技術基準適合認定及び設計認証)をすでに認証取得しています。新たに独自取得することなく届いたその日から安心してお使いいただけます。



5G通信で「sub6」を選ぶメリット

第5世代移動通信システム「5G」には、6GHz以下の周波数帯(主に3.7GHz帯および4.5GHz帯)を扱うsub6(サブシックス/サブロク)と28GHz帯を扱う「ミリ波」の2種類があります。sub6はミリ波と比べて通信可能範囲が広く、障害物の影響を受け難い特長があります。そして4G技術の転用ができることからsub6はミリ波と比べて先行して産業用途でも普及が進んでいます。

	メリット	デメリット
sub6	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信可能範囲が広い ・ミリ波と比べて、障害物の影響を受けにくい ・sub6は4G技術の転用ができる ・sub6はミリ波と比べて先行している(2021年現在) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信速度が遅い ・ミリ波と比べて、同時接続量が少ない
ミリ波	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信速度が速い ・sub6と比べて、低遅延 ・sub6と比べて、同時接続量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信可能範囲が狭い ・sub6と比べて、障害物の影響を受けやすい ・sub6はミリ波と比べて未だ普及していない(2021年現在)



生産工場・オフィス



交通・移動・物流



スマートシティ



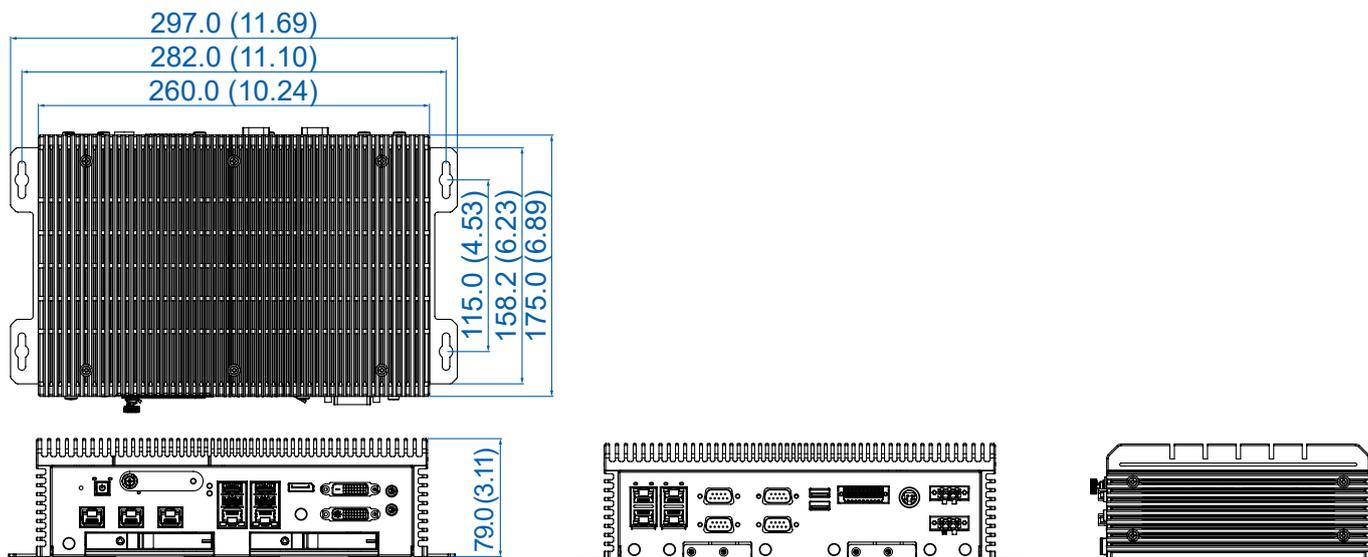
農林水産業

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名	Edge Tank™520	
5Gモジュール&アンテナ	sub6対応 ※TELEC取得済み	
SIMカードスロット	nanoSIM用スロット×2	
CPU	インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー (10C/20T/1.80GHz/TB 4.50GHz/20MB/Emb)	
チップセット	インテル® W480E	
メモリー	16GB (8GB×2枚、DDR4-2933、-40~+85℃)	
SSD	256GB (2.5inch、SATA、MLC、-40~+85℃)	
I/O	COM	4 (RS-232/422/485 (ESD 8KV))
	USBポート	USB 3.2 ×6
	Isolated DIO	16 Isolated DIO : 8 DI, 8 DO
	LAN	1GbE ×2 2.5GbE ×3
	PoE	4 (IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+)
ACアダプター	PWA-280W-WT (280W, 24V, 85VAC Industrial Grade)	
外観寸法 (WxDxH)	260.0 x 175.0 x 79.0 mm	
重量	約3.8Kg	

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Vii Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年9月現在の内容です。

国内使用が可能なTelec対応アンテナ&モジュールを標準搭載 届いた日からすぐ5Gが使える※「Edge Tank™」シリーズ

※通信事業者との5G回線契約が必要です。

Edge Tank™ 542

- ・インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサ
- ・COM×4、USB3.2×6、DIO×32

5G対応

GPU搭載可能

PoE+出力対応

耐環境性能

大容量ストレージ対応



5Gオールインワンパッケージ

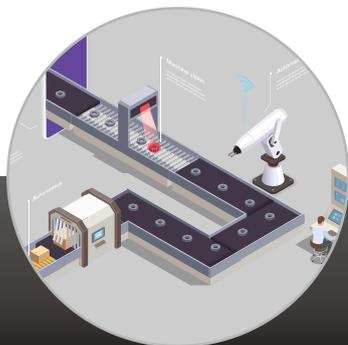
「超高速」「超低遅延」「多数同時接続」を実現する次世代通信5G/ローカル5G。日本国内で通信するために必要なTELEC(技術基準適合認定及び設計認証)をすでに認証取得しています。新たに独自取得することなく届いたその日から安心してお使いいただけます。



5G通信で「sub6」を選ぶメリット

第5世代移動通信システム「5G」には、6GHz以下の周波数帯(主に3.7GHz帯および4.5GHz帯)を扱うsub6(サブシックス/サブロク)と28GHz帯を扱う「ミリ波」の2種類があります。sub6はミリ波と比べて通信可能範囲が広く、障害物の影響を受け難い特長があります。そして4G技術の転用ができることからsub6はミリ波と比べて先行して産業用途でも普及が進んでいます。

	メリット	デメリット
sub6	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信可能範囲が広い ・ミリ波と比べて、障害物の影響を受けにくい ・sub6は4G技術の転用ができる ・sub6はミリ波と比べて先行している(2021年現在) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ミリ波と比べて、通信速度が遅い ・ミリ波と比べて、同時接続量が少ない
ミリ波	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信速度が速い ・sub6と比べて、低遅延 ・sub6と比べて、同時接続量が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・sub6と比べて、通信可能範囲が狭い ・sub6と比べて、障害物の影響を受けやすい ・sub6はミリ波と比べて未だ普及していない(2021年現在)



生産工場・オフィス



交通・移動・物流



スマートシティ



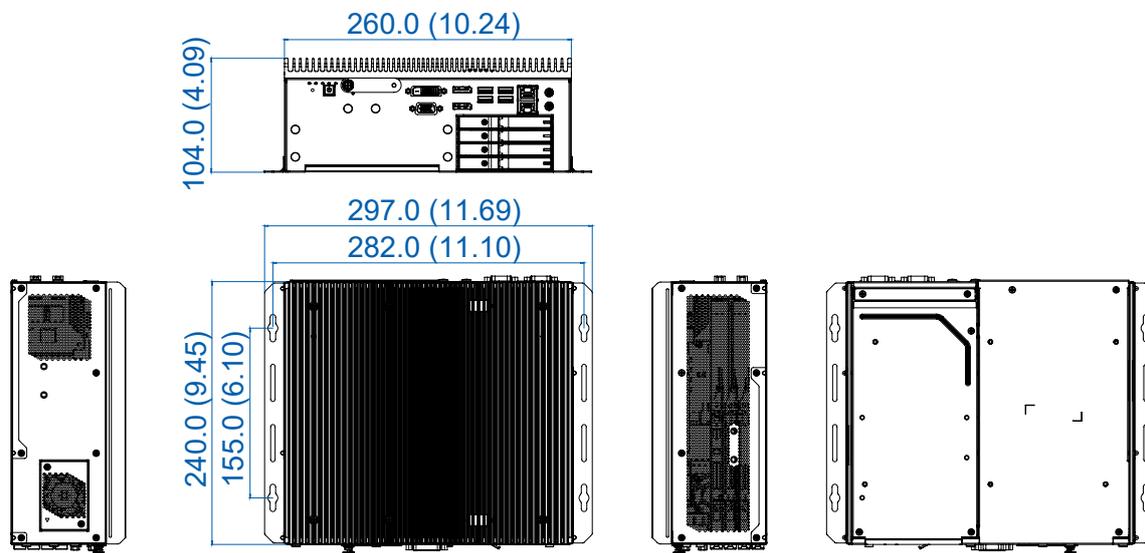
農林水産業

※画像はイメージです

■製品仕様

製品名	Edge Tank™542	
5Gモジュール&アンテナ	sub6対応 ※TELEC取得済み	
SIMカードスロット	nanoSIM用スロット×3	
CPU	インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー (10C/20T/1.80GHz/TB 4.50GHz/20MB/Emb)	
チップセット	インテル® W480E	
メモリー	16GB (8GB×2枚、DDR4-2933、-40~+85℃)	
SSD	256GB (2.5inch、SATA、MLC、-40~+85℃)	
I/O	COM	4 (RS-232/422/485 (ESD 8KV))
	USBポート	USB 3.2 ×6
	Isolated DIO	32 Isolated DIO : 16 DI, 16 DO
	LAN	1GbE ×2
	PoE	4 (IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+)
ACアダプター	PWA-280W-WT (280W, 24V, 85VAC Industrial Grade)	
外観寸法 (WxDxH)	260 x 240 x 104 mm	
重量	約5.5Kg (GPU搭載無し)	

■I/Oポート/ 寸法 単位:mm(inch)



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年9月現在の内容です。